

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЕЙ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ В АНСАМБЛЕ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ НА ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛА

*B.P. Maцокин*

Харьковский государственный университет

(Поступило в Редакцию 20 апреля 1994 г.

В окончательной редакции 7 декабря 1994 г.)

При повышенных температурах процесс образования контакта между дисперсной частицей и плоской поверхностью монокристалла сопровождается возникновением напряжений в области контакта и в непосредственной близости от него. При формировании контакта между одноименными веществами причины возникновения напряжений будут различными при геометрии сфера-плоскость и плоскость-плоскость. В первом случае напряжения вызываются капиллярной силой, приводящей к «идентированию» поверхности подложки [1]; релаксация этих напряжений происходит с образованием дислокационных скоплений, размеры которых превышают линейные размеры контакта [2]. Во втором случае из-за геометрического несовпадения кристаллических решеток дисперсной частицы и монокристальной подложки непосредственно под контактом формируется дислокационная структура, подобная структуре границы кручения [3].

При образовании контакта между дисперсной частицей и чужеродной подложкой из-за отличия в коэффициентах теплового расширения, различия в размерах атомов и парциальных коэффициентов диффузии контактирующих веществ абсолютные значения возникающих напряжений значительно больше, чем при припекании одноименных кристаллов. Напряжения релаксируют с образованием характерных дислокационных розеток и трещин как в области контакта, так и вне его [4]. Специфика релаксации зависит от вида напряженного состояния в контакте [5]. Так, в случае плосконапряженного состояния в результате релаксации напряжений в тонком приповерхностном слое порядка нескольких микронов образуются дислокационные розетки, состоящие из краевых и винтовых дислокаций и простирающиеся на расстояния, значительно превосходящие размеры области контакта [5].

В ансамбле дисперсных частиц, например в островковых пленках, наличие полей упругих напряжений и дислокаций в области контакта и вне его может повлиять на устойчивость островковых пленок, диффузионный обмен атомами между дисперсными частицами, вызывать их миграцию [6], привести к формированию специфического поверхностного рельефа [7].

Проведенные в данной работе экспериментальные исследования релаксации напряжений в ансамбле дисперсных частиц на поверхности щелочно-галоидных монокристаллов показали, что, варьируя расположение крупинок и расстояния между ними, можно существенно понизить уровень напряжений, уменьшить вероятность образования тре-

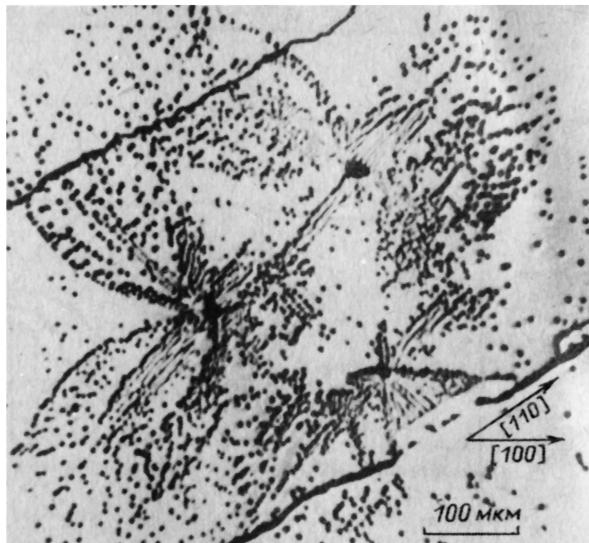


Рис. 1. Дислокационная структура вокруг кристалликов KCl на поверхности (001) монокристалла NaCl:  $T = 520^{\circ}\text{C}$ ,  $t = 0.5\text{ h}$ .

щин вблизи контакта и запретить возникновение дислокаций в области между крупинками (рис. 1).<sup>1</sup> Этот рисунок доказывает то, что дислокации в розетках, полученных при плосконапряженном состоянии, как отмечалось выше, возникают в тонком пришоверхностном слое кристалла. Действительно, участок поверхности кристалла, представленный на рис. 1, разделен ламелями (степеньками скола) высотой  $\sim 1\text{ }\mu\text{m}$  на три области, расположенные на разных уровнях (понижение от верха рисунка к низу). В нижней части микрофотографии дислокации розетки отсутствуют, т.е. они вышли из кристалла.

Полученные в [5] результаты позволяют проанализировать взаимодействие полей упругих напряжений от ансамбля чужеродных частиц на монокристальной подложке. На рис. 2 в качестве примера представлены контуры равных напряжений для компоненты  $\sigma_{xx}$ , ответственной за формирование контура розетки [5], для трех одинаковых частиц, создающих в области контакта равные деформации,  $\varepsilon > 0$  [5]. Координаты центров частиц следующие:  $(-2, -2)$ ,  $(2, -2)$  и  $(2, 2)$ . Ось  $X$  на рис. 2 — направление  $[100]$  на плоскости  $(001)$  щелочно-галоидного монокристалла.  $\tilde{X} = X/r_0$ ,  $\tilde{Y} = Y/r_0$ ,  $r_0$  — линейный размер дисперской частицы. Контуры напряжений построены в безразмерных величинах  $\tilde{\sigma}_{xx} = \sigma_{xx}/\sigma_0$  ( $\sigma_0 = 8(1 + \nu)Gh\varepsilon/\pi r_0$ ,  $\nu$  и  $G$  — коэффициент Пуассона и модуль сдвига вещества подложки соответственно,  $h$  — высота дисперской частицы) с шагом  $\Delta\tilde{\sigma} = 0.05$ . Внутри контуров, помеченных знаком 0, напряжения отрицательны, в остальной области — положительны. Наложение полей напряжений от разных частиц приводит к существенному изменению картины распределения напряжений. В частности, для компоненты  $\sigma_{xx}$  вдоль прямой, параллельной оси  $X$ , уменьшается градиент напряжений в области между частицами, расположенными в этом направлении. На расстояниях больших расстояния между частицами поле напряжений качественно подобно полю напряжений от отдельной частицы.

<sup>1</sup> Методика эксперимента и расчета напряжений описана в [5].

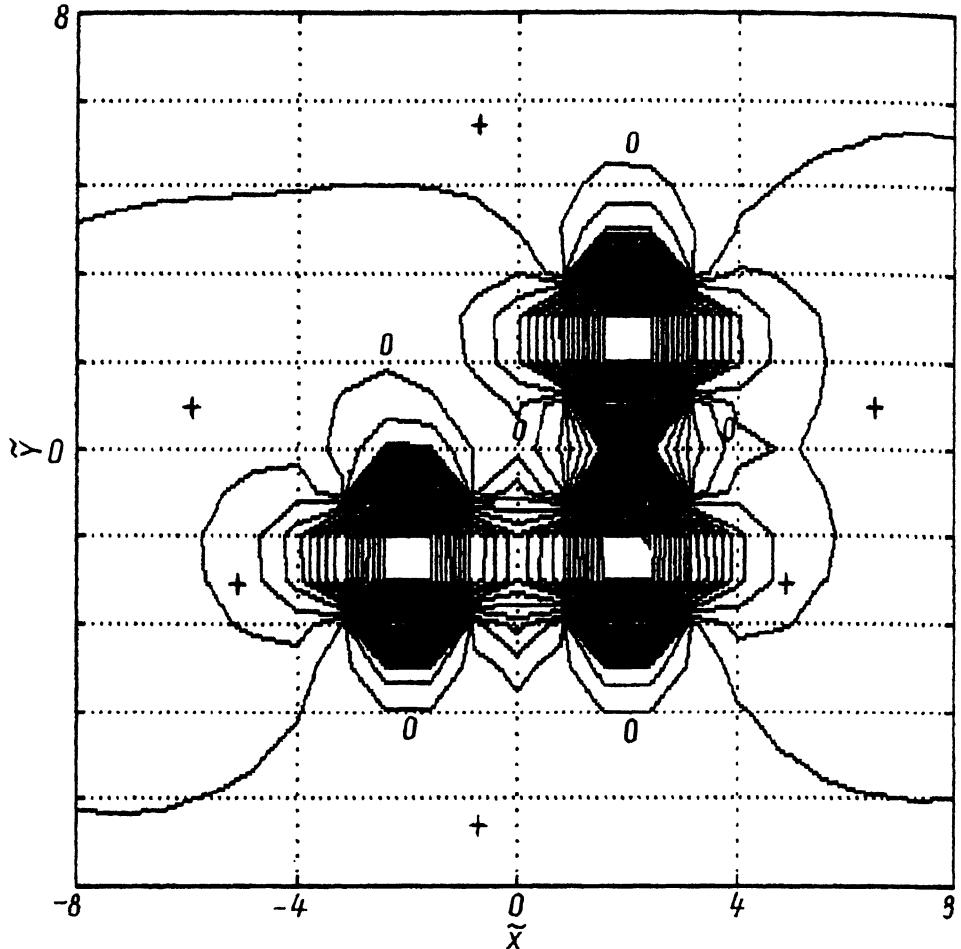


Рис. 2. Контуры равных напряжений  $\sigma_{xx}$ .

Взаимодействие полей напряжений, возникающих в ансамбле дисперсных частиц, и последствия их релаксации необходимо учитывать при использовании островковых пленок и при создании элементной базы в микроэлектронике.

#### Список литературы

- [1] Гегузин Я.Е., Дзюба А.С., Инденбом В.Л., Овчаренко Н.Н. Кристаллография **18**, 4, 800 (1973).
- [2] Just C.S., Morgan C.S. J. Nucl. Mater. **38**, 1, 182 (1963). . .
- [3] Гегузин Я.Е., Дзюба А.С., Мацокин В.П. УФЖ **29**, 9, 1419 (1984).
- [4] Гегузин Я.Е., Мацокин В.П., Витарс К. ДАН СССР **237**, 1, 82 (1977).
- [5] Мацокин В.П. ФТТ **35**, 9, 2455 (1993).
- [6] Гегузин Я.Е., Кагановский Ю.С. Диффузионные процессы на поверхности кристалла. М. (1984), 124 с.
- [7] Kaganovskii Yu.S., Lofaj F., Matsokin V.P. Scripta Met. Mater. **28**, 9, 1089 (1993).